

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-07

广东风华高新科技股份有限公司 关于技改扩产项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于公司半导体封装测试技改扩产项目的议案》和《关于新增月产 10 亿只 0201MLCC 技改扩产项目的议案》，现将项目有关情况公告如下：

一、半导体封装测试技改扩产项目

（一）项目概述

- 1、项目名称：半导体封装测试技改扩产项目
- 2、项目实施单位：公司控股子公司-广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称“粤晶高科”）
- 3、项目建设目标：新增半导体封装测试产能 11.04 亿只/年
- 4、项目建设期：2011 年 5 月—2012 年 5 月
- 5、项目预计投产日期：2012 年 5 月

（二）项目背景分析

全球半导体行业经历 2008 - 2009 年深幅下滑后，正进入新一轮的高速增长景气周期。半导体功率器件广泛用于电子制造业，汽车电

子、电子照明、工业自动化、仪器仪表、医疗电子、电子显示、3G通信以及节能节电是未来半导体分立器件市场的热点领域，受此影响，功率半导体器件(包括双极型和MOS)、IGBT市场呈现高速增长态势。

公司战略目标是成为国际一流的新型电子元器件整合配套供应商，作为提升整合配套能力的一个重要环节，公司规划未来加快提升新型半导体器件生产规模和技术水平。粤晶高科现有产品结构中SOT23类产品占比重较大，本项目着力于提高中高端小功率MOSFET、大功率MOSFET/IGBT产品生产能力和技术水平，使公司在中高端封装测试领域形成核心拳头产品，提升公司整体市场占有率和盈利水平。

(三) 项目的基本情况

1、项目建设产品内容：新增半导体封装测试产能 11.04 亿只/年，其中 SOT 系列产品新增年产能 3.84 亿只、TO 系列产品新增年产能 1.92 亿只、SOP 系列产品新增年产能 5.28 亿只。

2、设备方案与厂房规划

本项目利用现有厂房，并改造和配套基础建设投资为 738.2 万元，新增设备投资额为 7,162.41 万元。

3、人力资源规划

新增半导体封装测试产能 11.04 亿只/年的规模，需要员工约 168 名，其中生产线工人 133 名，管理、销售、技术开发人员约 35 名。

4、投资方案和财务评估

项目总投资约 9,900.6 万元，其中固定资产投资 7,900.6 万元（2011 年投入约 5,751.86 万元、2012 年投入约 2,148.72 万元），流动资金 2,000 万元。预计项目全部投产后，年新增销售收入约为 1.24 亿元，利润约为 2,394.8 万元。项目所需资金由公司自筹解决。

（四）项目的风险和对公司的影响

1、成本风险

本项目需用原材料主要有焊线、支架、塑封料等，近年来上述原材料价格均有不同程度的波动。受原材料价格及及人力资源成本上升等各种因素影响，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

对策：本项目投产后，将增加粤晶高科对下游供应商的采购量，进而提高材料采购议价能力，从而有效控制材料采购成本；在生产过程中，随着购进新一代设备的投入使用，可进一步提高生产原材料的利用率、减少材料损耗；随着设备管理能力、生产技术及工艺技术的提高，可进一步提高产品合格率、设备利用率及产能，从而最大限度降低单位产品成本；加大力度对主要材料进行替代开发的研究，在保证不降低产品性能的基础上使用低成本的材料，从而控制产品材料成本，如背银芯片替代背金芯片，镍基材镀厚铜框架替代镍基材镀银框架等。

2、市场风险

本项目市场风险主要来自于客户需求变化、市场竞争加剧、产品价格下降三个方面。

对策：半导体器件封装测试市场是一个靠规模、质量和服务取胜的市场，半导体封装测试未来将继续演绎“大者恒大，强者恒强”的产业竞争格局。公司将通过并加大投资力度以快速提高企业规模、降低运营成本、提高客户资源的获取能力，尽快形成适度规模。

加大客户结构调整和产品结构优化力度，加大力度开拓通信、计算机、医疗、汽车电子、LED 显示及照明等行业客户；积极拓展台湾等海外市场，以形成内外均衡、行业均衡的格局。

充分利用珠三角地区作为全球各式终端消费电子制造中心的有利条件，发挥地缘优势，缩短交货期及售后服务响应时间、加大技术支持力度，提高客户满意度。

3、新产品不能及时开发的风险

由于技术进步带来电子产品的快速更新换代，加之目前封装测试领域竞争的日益激烈，封装测试服务价格呈逐年下降趋势，导致产品边际利润空间日趋减小，封装测试企业只有通过持续的技术创新和高端新产品的研发才能获得较为稳定的利润率。

对策：公司将以市场、客户需求为导向，进一步开拓和进行产品的更新换代，以保持产品的竞争力。针对功率 MOSFET/IGBT 器件等封装产品的技术发展趋势并结合自身状况，制定长期技术发展规划，形成“生产一代、试制一代、预研一代”的良性循环体系。

4、新封装知识产权的约束风险

随着迈向 20nm 的超摩尔的线宽节点，封装越来越成为半导体达到设计初衷的瓶颈，特别是在专用处理器 ASIC，高集成度的系统级

封装模块 SIP 和超大容量内存等高性能产品方面，各世界级大公司已申请大量专利，开发了自主知识产权封装技术。国内公司要研发和制造此类产品，必须克服层层专利壁垒。

对策：公司研发和计划投产的 MOSFET/IGBT 都是属于晶体管和线性模拟产品类别，技术来源成熟，产品量大、面广、稳定，不存在新产品受新封装知识产权的约束风险。

二、新增月产 10 亿只 0201MLCC 技改扩产项目

（一）项目概述

- 1、项目名称：新增月产 10 亿只 0201 MLCC 技改扩产项目
- 2、项目实施单位：公司下属冠华片式陶瓷电容器分公司
- 3、项目建设目标：新增月产 10 亿只 0201 MLCC 产品
- 4、项目建设期：2011 年 6 月—2012 年 6 月
- 5、项目预计投产日期：2012 年 6 月

（二）项目背景分析

发展战略性新兴产业是我国十二五经济工作的核心内容，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业将成为国民经济的支柱产业。

作为高端电子信息产业，电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代，电子元器件技术逐渐主导电子信息整机技术发展方向，随着电子产品日趋精巧，小型化在电子产品行业里已成为发展的必然趋势。元器件的小型化不仅有助于实现电子整机产品小型化和便携化，而且增加了电路设计的自由度，减少了资源的消耗，降

低了成本，创造出新的价值。

在全球产业转移、国内产业升级、下游消费升级、城市化推进等因素的推动下，预计中国电子行业未来几年仍将保持 15-20% 左右的增长。从 MLCC 产品技术层次来看，尺寸越小、层数越多，技术层次越高，小尺寸是 MLCC 技术发展的一个主要方向，0201 乃至 01005 尺寸 MLCC 产品需求比例正迅速上升。

（三）项目的基本情况

1、项目建设内容：以生产 0201 系列 MLCC 产品为主，达产后新增年产 120 亿只。

2、设备方案与厂房规划：设备投资 7316 万元，利用公司现有生产场地进行生产。

3、人力资源规划

新增月产 10 亿只 0201 MLCC 的规模，需要员工约 148 名，其中生产工人 127 名，管理、技术、营销人员等 27 名。

4、投资方案和财务评估

项目总投资约 9066 万元，其中固定资产投资 7316 万元，新增流动资金 1750 万元。预计项目全部投产后将新增年营业收入 6384 万元，预计实现净利润 1769 万元。项目所需资金由公司自筹解决。

（四）项目的风险和对公司的影响

1、技术风险

0201 尺寸 MLCC 的技术难度远远大于传统的 0603 及 0402 主流产品，主要的技术风险在于研发技术与产业化技术能否相互匹配。

对策：公司在近几年连续对 MLCC 主营业务进行大规模的投入，储备了一批 0201 新产品研发成果，在 0201MLCC 所需要的新型材料、装备和薄介质薄层印刷等关键工艺技术上已实现突破；在本项目实施过程中，公司将建立有利于产业化技术创新的生产过程组织，通过 0201 高容和 0201 常规产品组合开发，降低整体风险，完善技术开发的风险预警系统，及时发现技术开发和生产过程中的风险隐患；同时，公司将发挥元件、材料、装备三位一体的优势，不断改良工艺、创新技术。

2、 经营风险

0201 MLCC 产业化后，经营风险主要来自成本上升和产能发挥饱和度的问题。0201 MLCC 规格小，材料应用上普遍采用贱金属工艺技术，单位额定标准材料成本非常低，且生产 0201 MLCC 需要自动化程度高的装备，需要规模化大批量生产，所以技改扩产后如何配合市场营销，充分发挥产能显得尤其重要。

对策：公司在 0201 尺寸片式元件上已经有了成功的营销经验，0201 尺寸片式电阻器已被终端整机客户大规模应用，其客户群与公司现有客户群的重合度很高。因此，利用现有营销渠道，可以确保在本项目 0201 MLCC 产业化后能够获得足够的市场份额支持。公司将积极主动做好销售前沿开拓，把新产品开发量产与营销开拓结合起来，从客户的研发阶段提前切入，做好重点客户的销售工作，发挥公司整合配套能力优势，为客户提供片容、片阻、片感以及其它电子元器件整合配套方案。

3、价格风险

全球片式电容器的整体价格呈现逐步下降的态势。近年随着 0201 MLCC 产品产业化进程的加快，产品逐步成熟，0201 MLCC 产品的价格将保持平稳下降。

对策：随着全球 MLCC 产业竞争格局的稳定，以及价格下降带动下游终端整机对 0201 规格 MLCC 的需求迅速增长，产品的供求关系已趋于平衡，产品价格将平稳下降。公司将推动加快集中力量开展新工艺、新材料、新技术的研发和应用，提高产品附加值。加快材料国产化步伐，降低材料成本，完善工艺质量管理体系，稳定和优化工艺，提高产品合格率。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月三十日